



Appel à communications
jcm2018.sciencesconf.org



Contact

Olivier MEYER, GeePs,

UMR 8507 - CentraleSupélec, UPMC, Paris-Sud
11 rue Joliot Curie, 91192 Gif-sur-Yvette

jcm2018@sciencesconf.org

Secrétariat : L2E - UPMC, BC252,
4, place Jussieu, 75005 Paris

Dates importantes

Limite d'envoi des résumés :

1er décembre 2017

Notification d'acceptation des contributions :

22 janvier 2018

Limite d'inscription au tarif réduit :

15 février 2018

Limite de dépôt des textes complets pour les actes
(4 pages) :

19 février 2018

Prix d'excellence

Un jury de membres du comité scientifique des JCMM 2018 décernera deux prix d'excellence, pour la meilleure communication étudiante orale et par affiche.

Présentation

Les Journées de Caractérisation Microondes et Matériaux (JCMM), se tiennent tous les deux ans depuis leur première édition en 1992. Elles ont pour objectif de rassembler et de promouvoir les échanges entre les communautés « composants et dispositifs microondes » et « sciences des matériaux ». De par leur caractère interdisciplinaire, les JCMM permettent de couvrir les domaines allant de l'élaboration des matériaux jusqu'aux applications. **Les applications visées concernent les technologies de l'information et de la communication, la biologie et la santé, ainsi que l'environnement** et plus généralement les disciplines scientifiques en phase avec les besoins actuels de la société.

Les communications se font majoritairement en français. Les contributions en anglais sont les bienvenues.



Thèmes

- ✓ **Elaboration et caractérisation des matériaux**
- ✓ **Techniques de caractérisation hyperfréquences**
- ✓ **Modélisations et simulations applications aux dispositifs micro-ondes**

concernant les matériaux :

- isolants, conducteurs, supraconducteurs, semiconducteurs,
- diélectriques, magnétiques, ferroélectriques, piézoélectriques
- céramiques, polymères, composites, monocristaux
- matériaux accordables, sélectifs en fréquence (FSS)
- bio-sourcés, naturels et artificiels
- multiferroïques, matériaux 2D (graphène...), textiles, organiques

sous forme

- amorphe ou cristallisée
- massive, couche mince, cristaux liquides
- céramique, polymère, composite...
- métamatériau, BIP, plasma ...

pour des applications

- en santé (médecine, biologie), télécommunication, électronique, capteurs, environnement...

pour des longueurs d'ondes allant du métrique au submillimétrique.

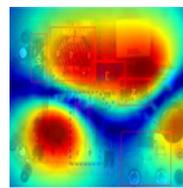
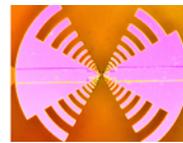
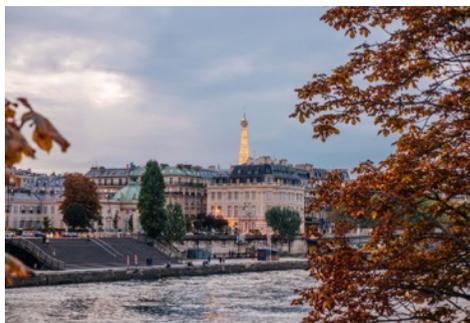
Organisation

Les 15^{èmes} Journées de Caractérisation Microondes et Matériaux sont co-organisées à Paris par le Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris (GeePs) et le Laboratoire d'Electronique et Electromagnétisme (L2E).

Les journées se tiendront à Paris à l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC, Sorbonne Universités), dans son Centre de Conférences, 4 place Jussieu, Paris 5^{ème}, du **19 au 21 mars 2018**.

Toutes les informations concernant l'organisation, le dépôt des résumés, les inscriptions, le programme sont sur

<https://jcm2018.sciencesconf.org/>



Exposants

Les entreprises sont invitées à exposer leurs produits couvrant les technologies actuelles relatives aux besoins de la communauté Microondes et Matériaux.

Comité scientifique

F. BOUST : DEMR ONERA, Palaiseau
D.CROS : XLIM, Limoges
R. CZARNY : Thales RT, Palaiseau
J. DAVID : Laplace, Toulouse
H. EZZEDDINE : ST Microelectronics, Tours
B. FLECHET : IMEP-LAHC, Chambéry
M. GUILLOUX-VIRY : ISCR, Rennes
H. GUNDEL : IETR, Nantes
P.M. JACQUART : Dassault Avion, Saint-Cloud
M. LEDIEU : CEA Le Ripault, Monts
C. LEGRAND : UDSMM, Calais
D. LIPPENS : IEMN, Villeneuve-d'Ascq
T. LASRI : IEMN, Villeneuve-d'Ascq
G. MAZE-MERCEUR : CEA-CESTA, Le Barp
O. MEYER : GeePs, Gif-sur-Yvette
F. NDAGIJIMANA : IMEP-LAHC, Grenoble
P. QUEFFELEC : Lab-STICC, Brest
B. SAUVIAC : LHC, Saint-Etienne
J. SOKOLOFF : Laplace, Toulouse
O. TANTOT : XLIM, Limoges
B. VIALA : CEA-LETI, Grenoble
V. VIGNERAS : IMS, Bordeaux

Comité local d'organisation

O. Meyer (co-président)
H. Kokabi (co-président)
A. Dégardin
F. Deshours
A. Diet
O. Dubrunfaut
A. Gensbittel
L. Pichon
H. Roussel